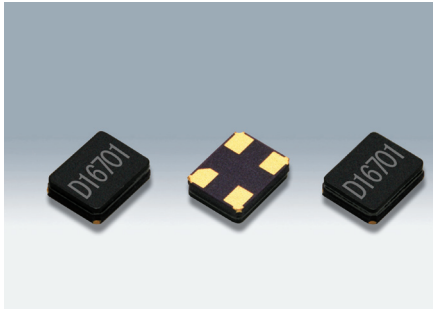


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

DSX321G



实际尺寸

■ 优点

- 3225尺寸、小型·薄型·轻量SMD晶体谐振器
厚度 DSX321G (12MHz以上) : 0.75mm
DSX321G (低于12MHz) : 0.85mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性(还可以支持面向通信用途的长期老化为 $\pm 1 \times 10^{-6}$ /年、 $\pm 3 \times 10^{-6}$ /5年的产品)
- 支持从7.9~64MHz的低频率开始的广泛频率
- 无需防湿包装管理 Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
- 依据AEC-Q200
- 也可支持完全无铅产品
- 支持工业设备使用(频率温度特性: $\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 ~ +105°C)



RoHS对应

■ 用途

- 通信机、DVC、DSC、PC等小型设备
- Bluetooth、无线局域网、GPS/GNSS等车载无线以及无钥匙进入系统、安全装置、多媒体设备等车载用途(依据AEC-Q200)
- 工业设备

■ 一般规格

| 项目 | 型号 | DSX321G | | | | | | |
|--------|----|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | 7.9~9MHz | 9~9.8MHz | 9.8~11MHz | 11~12MHz | 12~20MHz | 20~27MHz | 27~64MHz |
| 频率范围 | | 7.9~9MHz | 9~9.8MHz | 9.8~11MHz | 11~12MHz | 12~20MHz | 20~27MHz | 27~64MHz |
| 谐波次数 | | Fundamental | | | | | | |
| 负载电容 | | 8pF, 10pF, 12pF | | | | | | |
| 激励电平 | | 10μW (200μW max.) | | | | | | |
| 频率公差 | | $\pm 20 \times 10^{-6}$ (at 25°C) | | | | | | |
| 串联电阻 | | 400Ω max. | 300Ω max. | 150Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. | 50Ω max. |
| 频率温度特性 | | $\pm 30 \times 10^{-6}$ / -30~+85°C (Ref. to 25°C) | | | | | | |
| 保存温度范围 | | -40~+85°C | | | | | | |
| 包装单位 | | 3000pcs./reel (φ180) | | | | | | |

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DSX321G (低于12MHz)

[mm] ■ DSX321G (12MHz以上)

[mm]

| ■ DSX321G (低于12MHz) | | ■ DSX321G (12MHz以上) | |
|--|---|--|---|
| <p>■ 外形尺寸</p> <p>3.2±0.1 2.5±0.1 0.85±0.15 2.1 1.6 0.9</p> | <p>■ 内部连接</p> <p><Top View></p> <p>#4 #3 #1 #2</p> <p>#1、3为晶体端子 #2、4为开放(未连接)</p> <p>■ 焊盘图形(参考)</p> <p><Top View></p> <p>2.2 1.7 1.2 1.4</p> | <p>■ 外形尺寸</p> <p>3.2±0.1 2.5±0.1 0.75±0.15 2.1 1.6 0.9</p> | <p>■ 内部连接</p> <p><Top View></p> <p>#4 #3 #1 #2</p> <p>#1、3为晶体端子 #2、4为开放(未连接)</p> <p>■ 焊盘图形(参考)</p> <p><Top View></p> <p>2.2 1.7 1.2 1.4</p> |